



# ユーロ円CB発行に関する補足説明資料

---

株式会社アドバンテスト

2026年4月1日

# 本資料の取り扱いについて

---

本資料は、2026年4月1日に株式会社アドバンテスト(以下「当社」といいます。)が公表したプレスリリース「2031年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」の補足説明資料として作成されたものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債及び同社株式については国内における募集又は売出しは行われません。また、本資料は、米国を含むあらゆる地域における同社債又は同社株式の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債及び同社株式の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債及び同社株式の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債及び同社株式の募集又は販売は行われず、同社債及び同社株式の登録も行われません。

# 本件の概要

案件概要	
発行会社	株式会社アドバンテスト
発行形態	ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
募集市場	(Regulation-Sに基づく)欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く)
準拠法	英国法
発行決議日	2026年4月1日(水)
条件決定日	2026年4月1日(水)から2026年4月2日(木)午前8時(日本時間)までの間のいずれかの時間
払込期日	2026年4月20日(月)
年限(満期)	5年(2031年3月28日(金)償還)
発行金額	1,000億円
募集価格	102.50%
発行価額/償還価額	100.00%/100.00%
クーポン	0.00%
付帯条項	転換制限条項(～2030年3月31日:適用のある転換価額の150%/ 2030年4月1日～2030年12月28日:適用のある転換価額の130%)
ロックアップ	当社/引受契約書締結日から払込期日後180日を経過するまでの期間
手取金の用途	半導体テスト供給能力の増強(約500億円)/ 戦略的な在庫確保(約200億円)/ 次世代テスト・ソリューション開発の加速(約300億円)
ブックランナー	Nomura International plc / Daiwa Capital Markets Europe Limited / Mizuho International plc

# 本件実施の意義・目的

1

## CB発行の意義・背景

- HPC(ハイ・パフォーマンス・コンピューティング)／AI、高性能メモリなどを組み込む、先端パッケージの採用などを通じて複雑性の増加が進むAI関連半導体の生産数量増加とテスト高度化に対応
- 顧客の高まるテストへの需要に即応すべく生産能力を段階的に拡張することで、需要変動局面においても安定的かつ柔軟な供給体制を構築し、顧客との信頼関係を強化し、持続的な需要獲得とシェア拡大を企図
- 半導体の上流工程(開発・設計)と量産工程でのテスト効率化を推進するなど、テストフロー全体への包括的なテスト・ソリューションを提供し、SiConic™などEDA※との連携をはじめとするさらなる提供価値の向上や、テストへのAI活用の推進を企図

2

## CBを選択した理由・目的

- ゼロ・クーポンで発行されるため、金利コストの発生を回避し、資金調達コストの最小化を図った調達手段であること
- 時価を上回る転換価額の設定により、転換に伴う当面の1株当たり利益の希薄化を抑制する効果が期待されること
- 転換制限条項を付与することで、普通株式への転換可能性を相当程度抑制し、既存株主に配慮した負債性の高い商品設計となること
- 多様な資金調達手段の一つとして本新株予約権付社債を活用することで、今後の当社の事業ポートフォリオに応じた財務戦略の柔軟性向上が期待できること

※半導体設計自動化。Electronic Design Automationの略

# 今回調達資金の使途

調達資金(約1,000億円)

## コア事業の強化

半導体テスト供給能力の増強  
(SoC※1・メモリテストシステムの生産台数規模拡大)

約**500**億円

戦略的な在庫確保

約**200**億円

- 生産量増加と製品品質を両立するEMS※2の能力増強投資
- 生産技術の確立拠点である自社工場の機能強化
- 需要変動にスピーディーに対応するため、EMSと連携した柔軟な工程管理やプロセス可視化など、サプライチェーン全体のDX推進

- 顧客需要の急増にも対応するバッファーを含む部材調達

## 成長投資

次世代テスト・ソリューション開発の加速

約**300**億円

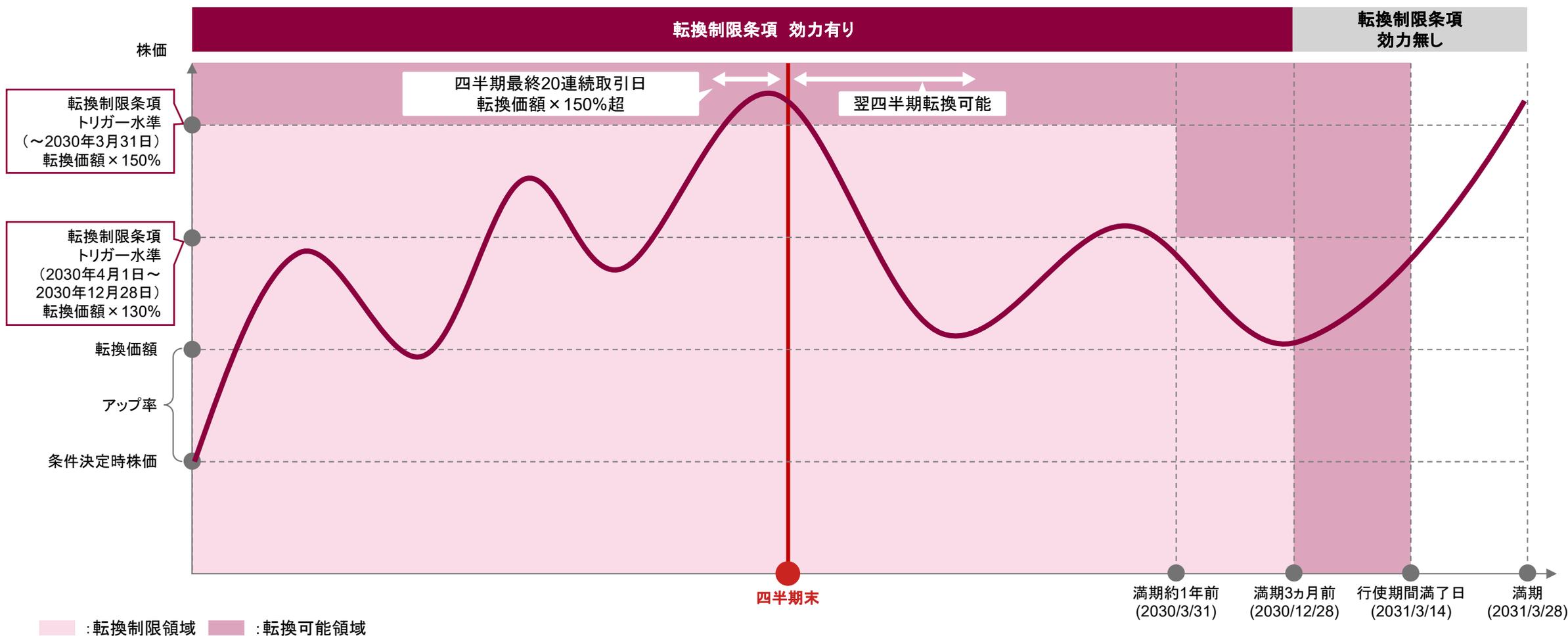
- テストフロー全体でのテスト効率化を図るため、顧客やテスト関連技術パートナーとの連携強化や、テストへのAI活用の推進

※1 SoC:異なる種類の複数の集積回路を1つのパッケージに集約したもの。System on a Chipの略

※2 EMS:電子機器製造受託サービス。Electronics Manufacturing Serviceの略

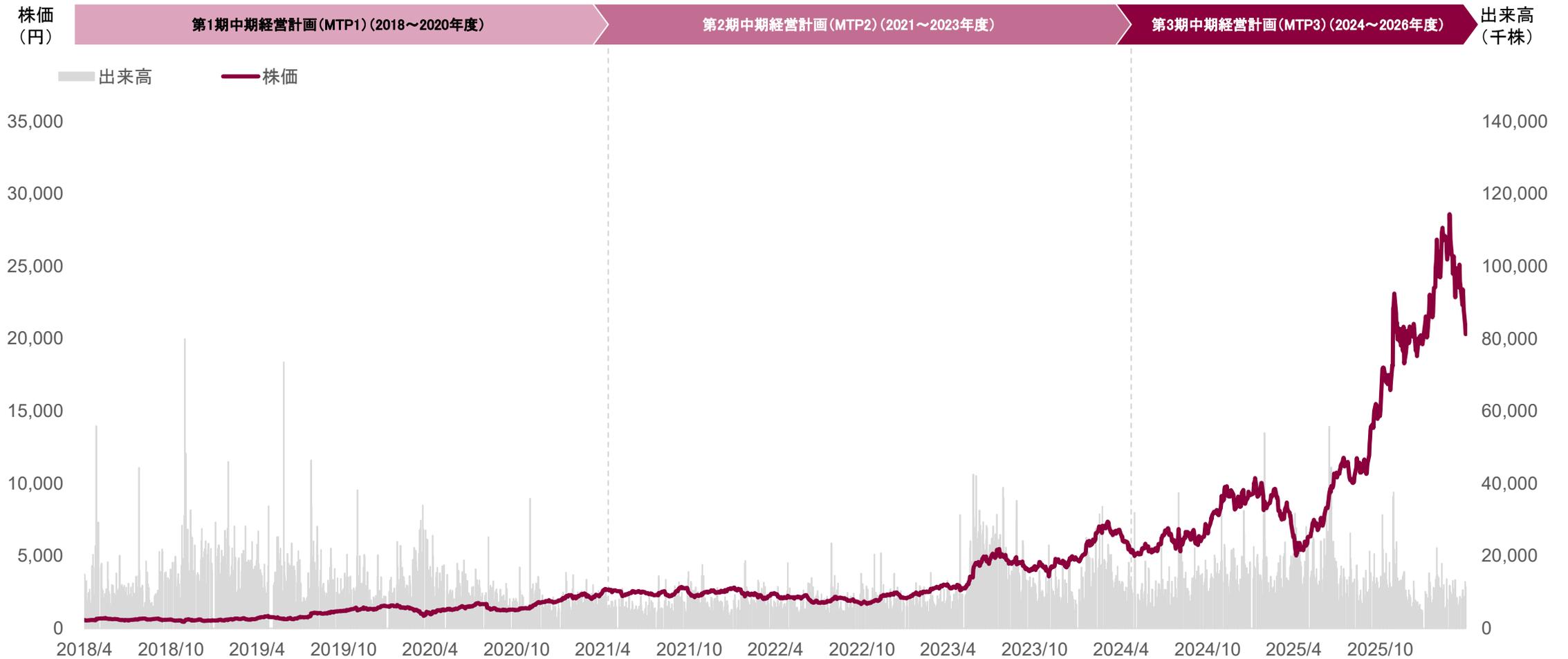
# 本件の商品設計

- 転換制限条項の付与により、期中の株価が転換価額の150%（～2030年3月31日）または130%（2030年4月1日～2030年12月28日）を一定期間超えて推移しない限り、CB投資家が転換請求することができない、負債性の高いスキームを採用



※株価変動は説明用のイメージであり、当社の株価の動きを予測又は保証するものではありません。

# <ご参考> 当社株価・出来高推移



※期間: 2018年4月2日から2026年3月31日まで

※株価は、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場における終値、2022年4月3日以前は東京証券取引所市場第一部における終値です。

※当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っており、2018年4月2日に当該株式分割が行われたと仮定して算出した出来高及び株価を記載しています。

# 経営理念 ビジョン&コア・バリュー

## The Advantest Way

アドバンテストは1954年の創業以来、計測技術を軸に成長し、半導体テストソリューションのリーディングカンパニーへと進化してきました。現在7,000名を超える従業員がグローバルに活躍する中「The Advantest Way」は、地域や文化を超えて従業員が共有する基盤であり、当社の企業理念であると同時に、すべてのステークホルダーへのコミットメントでもあります。

**経営理念 (パーパス&ミッション)** : 我々は何のために存在しているのか？

### 先端技術を先端で支える

私たちは、世界中の顧客にご満足いただける製品サービスを提供するために、たえず自己研鑽に励み、最先端の技術開発を通して社会の発展に貢献していきます。

**ビジョン** : 我々は将来どうなりたいのか？

### 半導体バリューチェーンで最も信頼され、最も価値あるテストソリューションカンパニーへ

当社グループは、提供価値の拡大を通じ、すべてのステークホルダーから半導体バリューチェーンで最も信頼され、最も価値あるテストソリューションカンパニーとなることを目指します。

**コア・バリュー** : 我々が大事に思うもの

**INTEGRITY** は異なる文化、習慣あるいは意見を受け入れる心であり、グローバルに展開する私たちが持つべきコア・バリューです。



**ADVANTEST®**